



Features

- ▶ 저비용을 위한 Cu 와이어 본드 또는 Ag 와이어 본드
- ▶ JEDEC 표준 패키지 규격
- ▶ 스트립 테스트 옵션을 포함한 턴키 테스트 서비스
- ▶ 친환경 재료 표준 - 무연, RoHS 준수

Process Highlights

- ▶ 웨이퍼 백그라인딩 대응
- ▶ 멀티 칩, 칩 스택 지원
- ▶ 다이 어태치 필름 및 ILT (Inner Lead Trace) 리드프레임을 이용한 COL (Chip-On-Lead) 지원
- ▶ Matte Sn 리드가 표준
- ▶ 패키지 레이저 마크

TSOP

앰코의 TSOP (Thin Small Outline Package)는 SRAM, FLASH, FSRAM 및 EEPROM 등 메모리 제품에 적합한 리드프레임 기반의 플라스틱 성형 패키지입니다. 이 패키지 제품군은 친환경 BOM을 표준으로 채택하여 무연 제품 및 유해물질규제(RoHS)를 준수하고 있습니다.

Reliability Qualification

앰코의 패키지 인증 시험에는 3개의 다른 제조 로트 및 테스트 그룹별 최소 77개의 유닛이 사용됩니다. 모든 테스트 과정은 JSTD-020에 준한 전처리 과정을 포함합니다.

- ▶ 수분감도 특성: JEDEC Level 1, 85 °C/85% RH, 168 hours
- ▶ uHAST: 130°C/85% RH, No bias, 96 hours
- ▶ 온도 사이클: -65/+150°C, 500 cycles
- ▶ 고온방치(HTS): 150°C, 1000 hours

Services and Support

앰코는 고객이 고품질 제품을 최대한 저렴한 비용으로 신속하게 시장에 출시할 수 있도록 각종 지원과 서비스를 아끼지 않고 있습니다.

- ▶ 맞춤형 리드프레임 설계
- ▶ 모든 패키지 특성화 지원
- ▶ 열 특성, 기계적 스트레스 및 전기적 성능 모델링
- ▶ 턴키 어셈블리, 테스트 및 드롭십
- ▶ 세계적인 수준의 신뢰성 테스트 및 불량 분석

Test Services

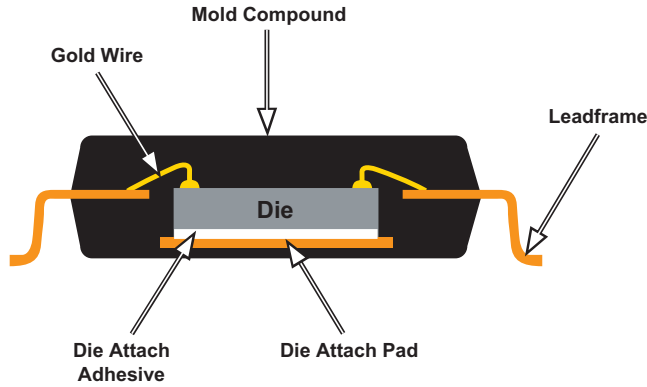
- ▶ 프로그램 생성/변환
- ▶ 웨이퍼 프로브
- ▶ 번인 테스트(Burn-in capabilities)
- ▶ -55 ~ +165°C 테스트 지원

Shipping Options

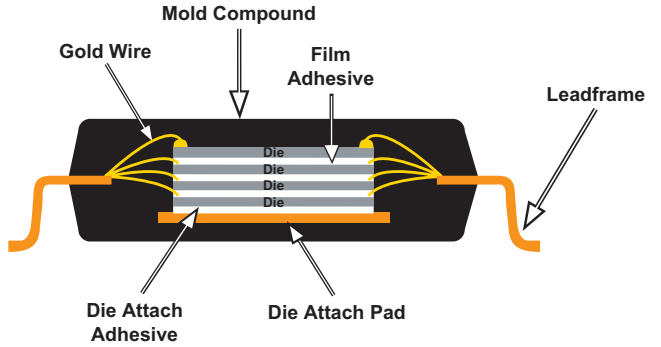
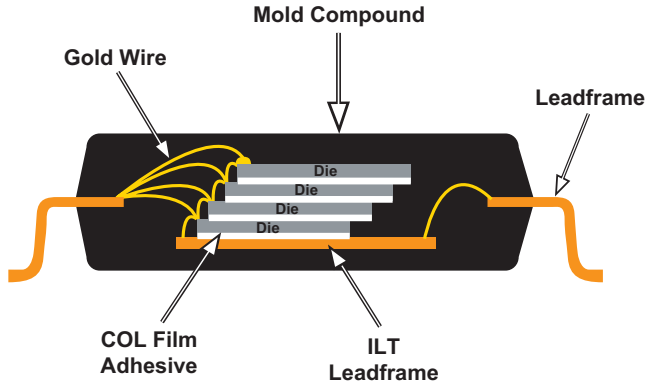
- ▶ JEDEC 개요 CD-020 로우 프로파일 트레이
- ▶ 바코드
- ▶ 드라이 팩
- ▶ 드롭십

TSOP

Cross Section TSOP



Cross Section Stacked TSOP



Configuration Options

TSOP Nominal Package Dimensions (mm)

Package	Lead Count	Body Width	Body Length	Body Thickness	Overall Height	Lead Pitch	Tip-to-Tip	JEDEC
TSOP 1	48	12.00	18.40	1.0	1.1	0.50	20.00	MO-142

자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.



본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다.
© 2019 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DS330L Rev Date: 05/19

